



平成 30 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 内 山 茂 樹  
 (コード番号：6615 東証第一部)  
 問合せ先 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長  
 岡 本 圭 三  
 (TEL 048-724-0001)

(訂正) 「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について

平成 30 年 5 月 24 日に開示いたしました「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」について、一部訂正がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

訂正箇所及び訂正内容 (訂正箇所は\_\_\_\_下線を付して表示しております。)

(訂正前)

<ご参考>

4. 調達資金の使途

(1) 今回の調達資金の使途

(省略)

会社名	事業所名(所在地)	セグメントの名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定年月		完成後の増加能力(注3.)
				総額(千円)	既支払額(千円)		着手	完了	
当社	本社・宮崎工場(埼玉県・宮崎県)	EMS事業	工場用地・建物・製造設備取得(注1.)、SMT(注2.)ライン新設	3,183,000		増資資金及び自己株式処分資金	平成30年4月	平成31年3月	2%増加
UMC Electronics HongKong Limited	本社(中国・香港)	EMS事業	SMT(注2.)ライン新設、工場増設	1,953,000		当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	9%増加
UMC Electronics Vietnam Limited	ベトナム工場(ベトナム・ハイズオン省)	EMS事業	SMT(注2.)ライン新設	1,021,000		当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	7%増加
UMC Electronics (Thailand) Limited	タイ工場(タイ・チャチューンサオ県)	EMS事業	SMT(注2.)ライン新設	596,000		当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	35%増加

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.	メキシコ工場(メキシコ・ハリスコ州)	EMS事業	SMT(注2.)ライン新設	441,000	—	当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	100%増加
--------------------------------------	--------------------	-------	---------------	---------	---	------------	---------	---------	--------

(注1.) 当社本社に係る設備の内容は、株式会社日立情報通信マニュファクチャリングを対象としたM&Aに伴う日立製作所所有の製造拠点の製造資産の取得であります。

(注2.) SMT: Surface Mount Technology (表面実装技術)。プリント基板の表面に電子部品を直接半田付けするものであり、高密度実装が可能となる技術。

(注3.) 完成後の増加能力は、SMTライン新設による生産能力の増加率を表しております。

(訂正後)

<ご参考>

#### 4. 調達資金の使途

##### (1) 今回の調達資金の使途

(省略)

会社名	事業所名(所在地)	セグメントの名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定年月		完成後の増加能力(注3.)
				総額(千円)	既支払額(千円)		着手	完了	
当社	本社工場・秦野工場・宮崎工場(埼玉県・神奈川県・宮崎県)	EMS事業	工場用地・建物・製造設備取得(注1.)、SMT(注2.)ライン新設	3,183,000	—	増資資金及び自己株式処分資金	平成30年4月	平成31年3月	103%増加
UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.	東莞工場(中国・広東省)	EMS事業	SMT(注2.)ライン新設、工場増設	1,953,000	—	当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	9%増加
UMC Electronics Vietnam Limited	ベトナム工場(ベトナム・ハイズオン省)	EMS事業	SMT(注2.)ライン新設	1,021,000	—	当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	7%増加
UMC Electronics (Thailand) Limited	タイ工場(タイ・チャチューンサオ県)	EMS事業	SMT(注2.)ライン新設	596,000	—	当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	35%増加
UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.	メキシコ工場(メキシコ・ハリスコ州)	EMS事業	SMT(注2.)ライン新設	441,000	—	当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	100%増加

(注1.) 当社秦野工場に係る設備の内容は、平成30年4月3日付「株式会社日立製作所とモノづくり強化協業で基本合意」及び平成30年4月5日付「(訂正)「株式会社日立製作所とモノづくり強化協業で基本合意」の一部訂正について」において公表した株式会社日立情報通信マニュファクチャリングを対象としたM&Aに伴う日立製作所所有の製造拠点の製造資産の取得であります。

(注2.) SMT: Surface Mount Technology (表面実装技術)。プリント基板の表面に電子部品を直接半田付けするものであり、高密度実装が可能となる技術。

(注3.) 完成後の増加能力は、SMTライン新設及び製造設備取得による生産能力の増加率を表しております。

以上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。